

# 日本嵌入式软件展2024

产品名称	日本嵌入式软件展2024
公司名称	江苏京硕展览有限公司
价格	.00/件
规格参数	展会名称:日本嵌入式软件展 展会时间:2024年01月17-19日 展会地址:日本大阪国际展览中心
公司地址	浦东新区龙阳路2345号
联系电话	16730229091 13816793095

## 产品详情

### 2024日本国际嵌入式系统展览会

### Japan IT Week-Embedded Systems Expo (ESEC)

展会时间：2024年01月17-19日 展馆名称：日本大阪国际展览中心

主办单位：RXJapan株式会社（日本励展集团）

展会周期：一年四届通

组展单位：上海贸升展览服务有限公司—日本展服务商

不参展人员，我司可提供组团观展服务，提供签证，机票，酒店，入场证办理等服务

另我司可代办日本签证（商务，旅游，三年多次，5年多次）材料简单，出签快

展会简介：

日本嵌入式系统展览会（Embedded Systems Expo简称：ESEC）是日本西部的嵌入式系统展览会。

展示嵌入式系统所需的一切的佳场所，从软件和组件到系统集成和开发平台。

参展范围：

- 1、微处理器DSP/硬件：MPU/MCU、DSP、ASSP/ASIC、FPGA/PLD、媒体处理器、嵌入式平台等。
- 2、软件：实时操作系统、中间件、设备驱动程序、软件组件、嵌入式Linux、嵌入式数据库、可用性相关解决方案、内置字体、其他软件IPEDA设计工具/系统：EDA工具、协同设计工具、协同验证工具等。
- 3、开发支持工具：ICE、仿真器、调试器、微机机箱、仿真器、系统设计工具、示波器、LSI设计/验证工具等。
- 4、其他：相关的产品/服务

日本嵌入式系统展ESEC大量的系统/硬件/软件设计人员、开发人员和工程师都希望为他们的业务引入新的解决方案。来自汽车及运输设备、FA设备、精密及医疗设备、通讯及移动设备、家电及影音等厂商的众多建筑师及开发商将出席并与参展商进行热烈的商务洽谈。